

**中信建投证券股份有限公司关于
美芯晟科技（北京）股份有限公司
2023 年半年度持续督导跟踪报告**

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：美芯晟科技（北京）股份有限公司
保荐代表人姓名：曾宏耀	联系方式：010-85130640 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层
保荐代表人姓名：董军峰	联系方式：021-68801585 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕521 号文”批准，美芯晟科技（北京）股份有限公司（简称“公司”或“美芯晟”）向社会公开发行人民币普通股 2,001 万股。本次公司发行新股的发行价为 75 元/股，募集资金总额为 150,075 万元，扣除发行费用 12,426.69 万元后，实际募集资金净额为 137,648.31 万元。本次公开发行股票于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具本 2023 年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐人已与美芯晟签订《保荐业务持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解美芯晟经营情况，对美芯晟开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司	本持续督导期，美芯晟未出现按有关规

	工作内容	持续督导情况
	违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	定须保荐人公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	本持续督导期，美芯晟未发生违法违规或违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	本持续督导期，保荐人督导美芯晟及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐人督促美芯晟依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐人对美芯晟的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，美芯晟的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐人督促美芯晟严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐人对美芯晟的信息披露文件进行了审阅，不存在相关文件存在问题应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期，美芯晟及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制	本持续督导期，美芯晟及其控股股东、

	工作内容	持续督导情况
	人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	经保荐人核查，本持续督导期美芯晟不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	本持续督导期，美芯晟未发生相关情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	本持续督导期，保荐人已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	保荐人持续关注上市公司的承诺履行情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现美芯晟存在重大问题。

三、重大风险事项

2023年1-6月，公司主要的风险事项如下：

（一）高端人才流失风险

集成电路设计行业属于智力和技术密集型产业，高端、专业人才是公司综合竞争力的体现和未来持续发展的基础。经过多年发展和培养，我国已拥有了大批集成电路设计行业从业人员，但与国际顶尖集成电路设计企业比，高端、专业人才仍然可贵难求。随着行业竞争日益激烈，同行业公司仍可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或公司受其他因素影响导致公司存在技术人员流失的风险。如果公司未来专业人才不能及时引进或既有人才团队出现流失，将对公司经营产生不利影响。

（二）大额研发投入风险

集成电路行业是资本密集型行业，技术迭代升级周期短，研发投入成本高。为保证产品的先进性，集成电路设计公司必须持续进行大量研发投入，通过不断的创新尝试并耗费一定的试错成本才能获得研发上的攻坚成果，因此所需要的大量研发资金需求形成了行业壁垒。随着市场需求不断迭代更新、产品制造工艺持续升级，若公司不能持续进行资金投入，或者在研发方向上未能正确做出判断，在研发过程中关键技术未能突破、产品性能指标未达预期，或者开发的产品不能契合市场需求，公司将面临研发失败的风险，前期的研发投入将难以收回，且会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。

（三）产品迭代风险

集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度快，持续研发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段。目前，行业内企业主要根据市场需求变动和工艺水平发展对现有技术进行升级迭代，以保持产品竞争力。未来如果公司不能及时准确地把握市场需求和技术趋势、突破技术难关，无法研发出具有商业价值、符合市场需求的新产品，将对公司竞争能力和持续盈利能力产生不利影响。

（四）行业市场环境变化对业绩影响风险

由于受到宏观经济环境变化的影响，全球半导体及集成电路市场存在一定的周期性波动，公司主要采购产品及服务的价格也随之存在起伏。2022年以来，芯片终端应用市场需求存在较大波动，境外新兴市场需求仍然保持相对旺盛，境内市场需求出现分化，整体需求放缓。同时，下游各环节库存去化程度不一，境外新兴市场需求能否保持持续旺盛，境内市场需求放缓的趋势能否扭转，仍然存在

不确定性。若未来供求失衡的状况无法持续改善甚至进一步恶化，则可能导致公司主要产品的收入或毛利率下滑，对公司整体业绩造成不利影响。

四、重大违规事项

2023 年上半年，美芯晟不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年半年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	200,648,032.01	133,414,040.84	50.39
归属于上市公司股东的净利润	11,003,075.50	-1,390,638.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,679,180.08	-6,061,940.78	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-133,312,769.44	-36,754,135.22	不适用
主要会计数据	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	本期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,062,855,738.68	675,369,610.56	205.44
总资产	2,151,460,269.35	742,490,952.49	189.76

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.17	-0.02	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.17	-0.02	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.07	-0.10	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	1.21	-0.22	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.51	-0.97	不适用
研发投入占营业收入的比例 (%)	20.29	22.57	减少 2.28 个百分点

公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

报告期内公司营业收入同比增长 50.39%，主要为电源管理芯片稳定增长、无线充电产品增幅较大所致；报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为 1,100.3 万元，较上年同期-139.06 万元，转亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 467.92 万元，较上年同期的亏损 606.2 万元，增加 1,074.11 万元；经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要为客户回款中银行承兑汇票占比增加、生产经营采购、员工薪酬和相关税费增加所致；归属于上市公司股东的净资产、总资产同比增加 205.44%、189.76%，主要为报告期内公司完成首次公开发行股票所致；基本每股收益、稀释每股收益和扣非后基本每股收益较上年同期转亏为盈，主要为净利润同比增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）创新的系统级思维能力与多学科融合的高集成技术内核

公司在诸多领域均通过创新的系统级思维能力提出了技术架构的创新，从而引领了业界设计潮流并保持领先优势。在 LED 通用驱动领域，公司首创单级高功率因数架构与恒流算法，取代了当时的双极架构，成为 LED 领域适用于大瓦数工商业照明的流行拓扑架构。在 LED 智能照明领域，开创性地提出了把 PWM 信号转变成模拟信号从而对 LED 光亮进行模拟量调节的方案，解决了以往直接采用 PWM 调光导致的频闪和噪声问题，引领了智能照明领域的调光架构变革。在无线充电领域，公司创造性地推出高功率 RX+4:2 电荷泵双芯片架构，在不改变线圈结构、输出电流能力的前提下，为无线充电功率到达并且突破 30W 提供了技术上的可能性，同时提升了无线充电的系统效率及可靠性。

公司拥有跨学科、多领域融合的高集成技术内核，并且具有前瞻性的市场定位能力，使得公司在产品定义与细分市场方面不断研发出高壁垒、高护城河的技术产品。在数模混合电源管理方向，公司融合模拟电源、数字设计与嵌入式软件等多学科技术，推出高集成度 MCU 数字控制 SoC 电源——无线充电芯片系列。在信号链领域，公司选择集成度较高的光传感领域切入，该领域是融合集光学、激光、工艺、数模混合 SoC 芯片为一体的传感器产品，之前均被海外厂家锁主导，国产替代空间广阔。在汽车电子领域，公司专注汽车电子中具有复杂架构的

高关键芯片，如 CAN SBC 等，是一颗集成了 CAN 收发器、系统模式和失效安全功能控制、电源管理功能的高集成单芯片，今早实现这类关键器件的国产替代。

（二）优秀的人才团队与坚实的知识产权壁垒

公司在国家特聘专家团队的带领下，引进了大批顶尖高校的硕博士，通过长期的技术培育和人才培养，构建了一支杰出的研发团队。公司研发人员占比约 60%，团队核心成员均具有 20 多年世界前沿的芯片及功率器件设计、系统架构、固件研发等经验积累。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 129 人，占公司人员比例近 60%。公司还通过股权与薪酬的激励有效结合，提高员工对公司发展的认同度，提高团队稳定性。

公司高度重视研发投入，保证不断创新的技术能力。围绕高电压、大电流、高集成数模混合电源管理等技术领域，公司通过技术创新，形成了上百项核心自主知识产权，并通过自主研发掌握了独特的高压集成工艺。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计申请专利 235 项，累计拥有境内授权专利共 130 项，其中发明专利 50 项，公司拥有的境外授权专利共 3 项，全部为发明专利。公司已在无线充电芯片、信号链光传感器、照明驱动芯片等领域构建了核心技术及知识产权体系，通过持续的技术创新和技术积累，建立了坚实的知识产权壁垒。

（三）先进的质量管理体系与快速高效的技术支持

公司把握“质量是企业生命”的原则，以“质量是永恒的主题”为引领，致力于持续不断提升质量，提供客户满意的产品，提升客户满意度。公司已建立了完善的质量管理体系。公司以 IT 系统为载体，构建了符合研发设计相关环节的 PLM 系统，将产品开发流程从产品规划、产品开发和验证、预量产到量产的全部环节形成有公司特色的全生命周期质量管理体系。公司建立了完整的供应商开发及管理体系，构建了良率监控系统，积极推动供应商资质完善，保证供应商的质量可控且不断提高。

同时，公司不断推进本土化的灵活销售与技术支持，全球 10 个分支机构配备相应的销售、市场应用与质量服务团队，形成“三位一体”服务客户的体系，为客户提供完整、快速、专业、便捷的服务，将产品质量控制贯穿设计、生产、客户服务完整链条，把握产品全生命周期的质量控制。

（四）丰富的应用领域与强大的客户资源体系

在国产替代的大背景下，公司凭借在模拟与数模混合芯片领域的技术积累、优秀的技术研发团队与成熟的质量管控体系，累计出货量超过 100 亿颗，产品选型超过 700 余款。凭借多年的行业深耕，公司已建立了完善的销售网络，与诸多行业知名终端客户建立了稳固的合作关系，实现了科技成果与产业的深度融合。未来公司将进一步持续开发高性能、多样化电源管理芯片和信号链芯片产品，以现有客户资源体系为基础，深化与终端品牌客户的合作关系，在应用终端构成覆盖通信终端、消费类电子、照明应用、智能家居、家电产品、汽车电子、工业控制等领域的战略布局。

公司在与终端品牌客户的合作过程中，一方面，这类客户对产品的技术特性、可靠性及升级迭代提出了较高的要求，通过频繁深入的技术沟通，公司不断提高自身的研发技术水平以匹配品牌客户的技术需求，拓展了公司产品定义的深度与广度。另一方面，在成功导入主流客户的供应商体系后，产品的品质管控和战略布局进一步提升，品牌客户对公司产品的技术与质量形成背书，提升了公司产品的业务能力与市场壁垒。

（五）稳定的供应链合作关系与自研工艺开发能力

在目前的产业格局下，供应链是保障半导体及集成电路设计公司稳定发展的重要环节。公司基于自主研发的技术体系及工艺开发平台的能力拓展，与华虹宏力、台积电、燕东微电子、中芯国际等国内外主要晶圆厂家，以及气派科技、晶导微电、华天科技等封测厂进行广泛的业务合作与战略协同，进行产品设计与生产工艺的深度融合与优化，满足多应用领域的场景适应性需求，保证公司产品竞争力的同时，巩固了公司稳定的供应链渠道优势。

在 BCD 高压集成工艺开发方面，公司是业内极少同时具备自研工艺开发能力的芯片设计企业。建立了自有工艺研发团队，具有自主研发工艺及开发特殊器件的能力，不再单纯依赖晶圆代工厂提供的标准工艺。公司自主研发的 700V-BCD 高压集成工艺和 100V-BCD 器件工艺能够促进芯片生产成本的优化以及供应链整合，大幅提升公司产品的市场竞争力，为产品不断升级和迭代奠定了独特性和差异化优势，并为信号链传感器芯片的设计研发、灵敏度优化、抗噪声能力

增强等方面打下良好的基础。

七、研发支出变化及研发进展

报告期内公司研发投入情况如下：

单位：元

主要财务指标	2023年1-6月	2022年1-6月	变化幅度(%)
费用化研发投入	40,713,386.34	30,113,634.95	35.20
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	40,713,386.34	30,113,634.95	35.20
研发投入总额占营业收入比例(%)	20.29	22.57	减少 2.28 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	-	-	-

2023 年上半年，公司增加研发投入大力开发新产品，研发人员增加至 129 人，薪酬增加、测试费、材料费、专利费等研发费用大幅增加，使得公司研发费用比上年同期增加 35.20%。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计获得国际发明专利授权 3 项，获得国内发明专利授权 50 项，实用新型专利 69 项，集成电路布图设计专有权 11 项。报告期内，公司新增知识产权项目申请 34 项（其中发明专利 18 项），获得新增授权专利 13 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募资金额	150,075.00
减：发行费用	9,807.50
募集资金净额	140,267.50
减：投入募集资金项目的金额	21,598.38
减：期末闲置募集资金现金管理尚未到期收回金额	99,000.00
加：募集资金账户的利息收入扣减手续费金额	230.41
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	19,899.53

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

为提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 6 月 9 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度和使用期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司进行现金管理的募集资金金额为 99,000.00 万元，情况如下：

单位：万元

签约银行	产品名称	收益类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期
北京银行股份有限公司马连道支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2023-06-13	2023-12-13	1.55%或2.75%	否
北京银行股份有限公司马连道支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023-06-13	2023-09-13	1.3%或2.69%	否
招商银行股份有限公司北京海淀科技金融支行	结构性存款	保本浮动收益型	38,000.00	2023-06-14	2023-09-14	1.65%或2.8%	否
招商银行股份有限公司北京海淀科技金融支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2023-06-21	2023-08-21	1.65%或2.8%	否
中信银行股份有限公司北京分行三元桥支行	结构性存款	保本浮动收益型	25,000.00	2023-06-19	2023-09-19	1.05%或2.58%或2.98%	否
兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行	结构性存款	保本浮动收益型	18,000.00	2023-06-20	2023-09-18	1.5%或2.46%	否
合计			99,000.00	-	-	-	-

公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）持股情况

1、控股股东

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东 Leavision Incorporated 持有公司 12,717,886 股，持股比例为 15.90%。

2、实际控制人、董事、监事和高级管理人员

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：

序号	名称	说明	持股数量（股）	持股比例
1	程宝洪	董事长	12,717,886	15.90%
2	刘柳胜	董事	3,134,199	3.92%
3	冷雄	监事会主席（职工代表监事）	79,659	0.10%
4	赵兴涛	监事	159,193	0.20%
5	郭越勇	副总经理	1,507,962	1.88%
6	钟明	副总经理	1,238,821	1.55%
7	于龙珍	财务负责人	304,820	0.38%
8	刘雁	董事会秘书	593,210	0.74%

除上述持股公司股份外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均未以其它方式直接或间接持有公司股份。

（二）质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 曾宏耀
曾宏耀

董军峰
董军峰

